

****荷声科技（Sonosilicon）**〔新增〕项目介绍**

一、公司概况

所属基金群：中金资本（中金资本 / 中金启元 / 中金佳成）

细分赛道：高端器械

当前阶段：早期（芯片/模组研发，产业化推进）

总部城市：杭州

二、主营业务与投资亮点

主营业务：微型片上超声模组与系统；依托面阵 ASIC、硅基超声换能器（自主 eMUTrix™ 有源面阵超声）+ 边缘计算超声 AI，构建“芯片—模组—智能系统”自主技术链；布局四维心腔内超声（4 D-ICE）、微型环阵血管内超声（R-IVUS）、可穿戴超声贴片、超声脑机接口

三、核心地位与原创性

产品 / 首创补充：**国内唯一具备四维面阵超声成像芯片自研能力**；**全球少数拥有片上超声闭环体系**的创新主体

四、资本与基金布局

具体出资方 / 主体：阿斯利康中金医疗产业基金（领投），中芯聚源、杭州高新金投、上海拙朴跟投

投资轮次：Pre-A轮

投资时间：2025-12-18

投资金额：未披露

五、数据来源

基金官网/投资组合、基金业协会备案、企业工商信息及主流财经媒体公开报道；医疗项目为代表性案例（非穷尽），部分信息标注(待核验)。本页由多 Agent 并行研究生成，仅供内部投研参考。